

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-121797

(43)Date of publication of application : 30.04.1999

(51)Int.CI. H01L 33/00

(21)Application number : 09-283316

(71)Applicant : MATSUSHITA ELECTRON CORP

(22)Date of filing : 16.10.1997

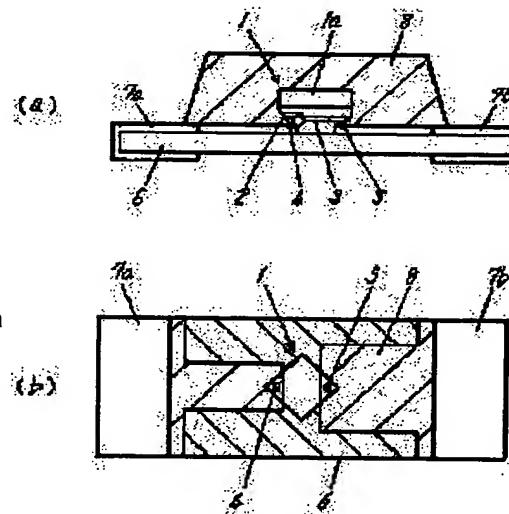
(72)Inventor : MURATA HIROSHI
KITAZONO TOSHIRO
INOUE TOMIO
NEI MASAMI

(54) CHIP TYPE SEMICONDUCTOR LIGHT EMITTING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a thin chip type semiconductor light emitting device electrically connected to the lead side by substantially reducing the thickness of parts occupied by wires to zero, without reducing the thickness of the light emitting itself.

SOLUTION: This light emitting device comprises a light emitting element 1 having an n- and p-electrodes 2, 3 on the same face facing a crystal substrate 1a. This element 1 is mounted on a lead substrate 6. The substrate 1a transmits light, microbumps 4, 5 are formed on the n- and p-electrodes 2, 3, the crystal substrate 1a is inverted upside down with respect to the lead substrate 6 to connect the microbumps 4, 5 to leads 7a, 7b formed on the chip substrate 1a, without wire-bonding to the electrodes 2, 3 and the top face of the crystal substrate 1a is used as a light take-out face.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 29.01.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-121797

(43)公開日 平成11年(1999)4月30日

(51)Int.Cl.*

H 01 L 33/00

識別記号

F I

H 01 L 33/00

C

審査請求 未請求 請求項の数3 O L (全 6 頁)

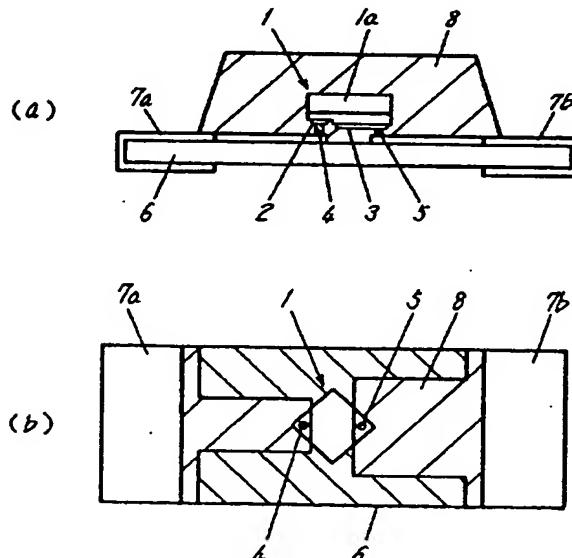
(21)出願番号	特願平9-283316	(71)出願人	000005843 松下電子工業株式会社 大阪府高槻市幸町1番1号
(22)出願日	平成9年(1997)10月16日	(72)発明者	村田 博志 大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業 株式会社内
		(72)発明者	北園 俊郎 大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業 株式会社内
		(72)発明者	井上 登美男 大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業 株式会社内
		(74)代理人	弁理士 滝本 智之 (外1名) 最終頁に続く

(54)【発明の名称】チップ型半導体発光装置

(57)【要約】

【課題】発光素子自体の厚さを薄くしないでもワイヤーが占めていた分の厚さ方向の嵩を実質的に零としてリード側に導通接続した薄型のチップ型半導体発光装置を提供する。

【解決手段】結晶基板1aと対向する同一の面にn側電極2及びp側電極3を備えた発光素子1をリード基板6に搭載する半導体発光装置において、結晶基板1aを光透過性とし、n側及びp側電極2、3のそれぞれの上にはマイクロバンプ4、5を形成し、結晶基板1aをリード基板6に対して上下反転した姿勢としてマイクロバンプ4、5をチップ基板1aに形成したリード7a、7bに接続し、n側及びp側の電極2、3に対してワイヤーボンディングすることなく、結晶基板1aの上面を光取出し面とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】結晶基板の上に少なくともn型層及びp型層を成長させた積層構造を持ち且つ結晶基板と対向する同一の面にn側電極及びp側電極を備えた発光素子をリード基板に搭載するチップ型の半導体発光装置であって、結晶基板を光透過性とともに、n側電極及びp側電極のそれぞれの上には導電性材料からなるマイクロバンプを形成し、結晶基板をリード基板に対して上下反転した姿勢としてマイクロバンプをリード基板に形成したりードに接続し、結晶基板の上面を光取出し面としてなるチップ型半導体発光装置。

【請求項2】結晶基板を絶縁性のサファイアとともに、n型層及びp型層を窒化ガリウム系化合物の半導体薄膜によって形成し、p型層の一部を除去してn型層を露出させ、p型層及び露出したn型層のそれぞれに電極を形成してなる請求項1記載のチップ型半導体発光装置。

【請求項3】結晶基板を透明のn型GaN基板とともに、n型層をGaN系化合物の半導体薄膜により形成し、n型層表面近傍の一部に亜鉛拡散を行なうことによりp型層を形成させ、n型層及びp型層のそれにn側電極及びp側電極を形成した発光素子をリード基板に搭載するチップ型の半導体発光装置であって、n側電極及びp側電極のそれぞれの上には導電性材料からなるマイクロバンプを形成し、結晶基板をリード基板に対して上下反転した姿勢としてマイクロバンプをリード基板に形成したりードに接続し、結晶基板の上面を光取出し面としてなるチップ型半導体発光装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、たとえば青色発光ダイオード等の光デバイスに利用される窒化ガリウム系化合物を利用したチップ型の半導体発光装置に係り、特に発光装置の厚みをさらに薄く形成できるようにしたチップ型半導体発光装置に関する。

【0002】

【従来の技術】GaN, GaAlN, InGaN及びInAlGaN等の窒化ガリウム系化合物半導体は、可視光発光デバイスや高温動作電子デバイス用の半導体材料として多用されるようになり、青色発光ダイオードの分野での展開が進んでいる。

【0003】この窒化ガリウム系化合物の半導体の製造では、その表面において半導体膜を成長させるための結晶基板として、一般的には絶縁性のサファイアが利用される。このサファイアのような絶縁性の結晶基板を用いる場合では、結晶基板側から電極を出すことができないので、半導体層に設けるp, nの電極は結晶基板と対向する側の一面に形成されることになる。これに対して、窒化ガリウム系以外のGaNやGaP等の半導体基板を利用する発光素子では、たとえば下層をn型層及び上

層をp型層としてこれらのn型層及びp型層のそれぞれにn側電極及びp側電極を設けることができる。

【0004】このように、半導体膜を成長させる結晶基板によって、n側及びp側の電極の配列の様子が異なるが、いずれにおいても少なくとも一方の電極についてはワイヤーボンディングによってリードに接続することについては共通である。すなわち、導電性の半導体基板を用いるものでは、この半導体基板をたとえばこれをn型層に導通させてリードに接続するとともに、p型層についてはその電極をワイヤーボンディングによって別系統のリードに接続すればよい。また、青色発光ダイオードのように絶縁性のサファイアを用いるものでは、n側及びp側の電極のそれぞれにワイヤーボンディングを施すことになる。

【0005】図4は導電性の基板を用いた従来のチップ型の発光ダイオードの概略であって、同図の(a)はその縦断面図、同図の(b)は平面図である。

【0006】図において、絶縁性の基板21にリード22a, 22bが形成され、一方のリード22aの上に発光ダイオードの発光素子23が搭載されて銀等をフィラーとして主剤中に混入した導電性ベースト22cによって固定保持されている。

【0007】発光素子23は最も簡単な例として下層をn型層及び上層をp型層としてp-n接合されたものとすると、下端に位置するn側電極23aをリード22aに導通させ、上端のp側電極23bにはAu等を素材とするワイヤー24を他方のリード22bとの間にボンディングして導通させることで、発光素子23は電気的に接続される。そして、発光素子23及びワイヤー24の全体を含んでボンディングエリアの全体も含めて透明なエポキシ樹脂25によって封止されている。

【0008】このような発光素子23を用いるチップ型の発光装置の分野では、リード22a, 22bから透明なエポキシ樹脂25の上端までの厚さTを薄くすることが、薄型化による実装容積の低減の点から、発光ダイオードの分野では重要な課題として残されている。現在では、この厚さTは300~400μm程度までに抑え込まれるまでになり、たとえば直径が3~5mm程度のLEDランプに比べると格段に小型化されたといえる。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】発光装置の厚さTをより短くして更に薄型化するためには、発光素子23自体の厚みを小さくするか、図示のようにワイヤー24の上向きの嵩張りを抑えるか、もしくはこれらの両方とするかが有効な手段として考えられる。

【0010】しかしながら、図示の例からも判るように、発光素子23の全体の厚さとワイヤー24がp側電極23bから上に突き出る長さは殆ど変わらないこと、及び発光素子23には多様な種類のものがあって結晶基板に積層する半導体薄膜の種類と積層形態を様々に変え

て発光効率等の向上を図るためににはその積層厚さに下限があることから、ワイヤー24の嵩張りを排除するほうが一般的には対処しやすい。

【0011】このようなワイヤー24による全体の厚さ方向への嵩張りを抑えるには、たとえば同図の(a)において一点鎖線で示すように、ワイヤー24をp側電極23bから立ち上げないでその接続点から直にリード22b側に曲げるようなワイヤーボンディングとすることが一つの方法として挙げられる。このようなワイヤー24の配線であれば、厚さ方向の嵩が無くなるのでこの分に相当して厚さTを小さくすることが可能である。

【0012】ところが、一点鎖線で示すようなワイヤー24のボンディングでは、透明なエポキシ樹脂25によって樹脂封止する工程での拘み変形や経時後の機械的または熱的な応力負荷によって、ワイヤー24が発光素子23の表面とくに上端側の角部分に接触してしまう恐れがある。そして、このような発光素子23へのワイヤー24の接触が発生すると短絡を起こすことになり、発光素子23の損傷や発光表示不良の事態を招くことになる。

【0013】このようなことから、ワイヤー24と発光素子23との間の短絡を防止するには、図示のようにp側電極23bから一旦立ち上げてからリード22b側に曲げるというワイヤーボンディングとするしかない。そして、このようなワイヤー24のボンディングについての制約は、チップ型だけではなくLEDランプでも同様である。

【0014】以上のように、発光装置における厚さTを決める因子である発光素子23及びワイヤー24のいずれについても、厚さTを小さくすることには、もはや何ら貢献することはできない。したがって、新たな形態の発光素子の開発を待たなければ、発光装置の厚さTを300μm以下にまで引き下げることができないというのが現状である。

【0015】そして、窒化ガリウム系化合物の半導体において絶縁性のサファイアを結晶基板とする場合にp側及びn側の電極を同じ面に設ける必要がある発光素子においても、これらの2個の電極のそれぞれにワイヤーをボンディングするので、同様の問題を生じることになる。また、このタイプの発光素子ではp型層が光取出し面となるが、この光取出し面の一部をワイヤーボンディングのためのボンディングパッドが占めるので、その面積に相当して光取出し面積が減少してしまい、このことが発光効率の低下を招くことにもなる。

【0016】このように、従来のチップ型の発光装置では、発光素子及びワイヤーの形状や嵩の最適化を図っても全体の厚さについては下限があり、薄型化に向けての対策が待たれている。

【0017】本発明において解決すべき課題は、発光素子自体の厚さを小さくしないでもワイヤーが占めていた

分の厚さ方向の嵩を実質的に零としてリード側に導通接続した薄型のチップ型半導体発光装置を提供することにある。

【0018】

【課題を解決するための手段】本発明は、結晶基板の上に少なくともn型層及びp型層を成長させた積層構造を持ち且つ結晶基板と対向する同一の面にn側電極及びp側電極を備えた発光素子をリード基板に搭載するチップ型の半導体発光装置であって、結晶基板を光透過性とするとともに、n側電極及びp側電極のそれぞれの上には導電性材料からなるマイクロパンプを形成し、結晶基板をリード基板に対して上下反転した姿勢としてマイクロパンプをリード基板に形成したリードに接続し、結晶基板の上面を光取出し面としてなることを特徴とする。

【0019】このような構成では、p側及びn側のいずれの電極に対してもワイヤーボンディングによるリード側との電気的接続が不要となるので、ワイヤーの発光素子からの立ち上がりに相当する嵩がなくなり、発光素子の薄型化が可能となる。また、結晶基板は電極を備えていない側の面の全体を発光観測面として与えるので、ボンディング用のパッド等の介在がなく、発光効率の向上が図られる。

【0020】また、結晶基板を透明のn型GaN基板とともに、n型層をGaNAsP系化合物の半導体薄膜により形成し、n型層表面近傍の一部に亜鉛拡散を行なうことによりp型層を形成させ、n型層及びp型層のそれぞれにn側電極及びp側電極を形成したフリップチップ型の発光素子についても、n側電極及びp側電極のそれぞれにマイクロパンプを形成して結晶基板の上面を光取出し面となるようにリード基板のリードにこれらのマイクロパンプを接続する構成としてもよい。

【0021】

【発明の実施の形態】請求項1に記載の発明は、結晶基板の上に少なくともn型層及びp型層を成長させた積層構造を持ち且つ結晶基板と対向する同一の面にn側電極及びp側電極を備えた発光素子をリード基板に搭載するチップ型の半導体発光装置であって、結晶基板を光透過性とするとともに、n側電極及びp側電極のそれぞれの上には導電性材料からなるマイクロパンプを形成し、結晶基板をリード基板に対して上下反転した姿勢としてマイクロパンプをリード基板に形成したリードに接続し、結晶基板の上面を光取出し面としてなるものであり、p側及びn側のいずれの電極に対してもワイヤーボンディングによるリード側との電気的接続が不要となるので、ワイヤーの発光素子からの立ち上がりに相当する嵩がなくなり、発光装置の薄型化が可能となる。また、結晶基板は電極を備えていない側の面の全体を発光観測面として与えるので、ボンディング用のパッド等の介在がなく、発光効率の向上が図られる。

【0022】請求項2に記載の発明は、結晶基板を絶縁

性のサファイアとともに、n型層及びp型層を窒化ガリウム系化合物の半導体薄膜によって形成し、p型層の一部を除去してn型層を露出させ、p型層及び露出したn型層のそれぞれに電極を形成してなるものであり、輝度の高い青色及び緑色の発光が得られるという作用を有する。

【0023】請求項3に記載の発明は、結晶基板を透明のn型GaP基板とともに、n型層をGaAsP系化合物の半導体薄膜により形成し、n型層表面近傍の一部に亜鉛拡散を行なうことによりp型層を形成させ、n型層及びp型層のそれぞれにn側電極及びp側電極を形成した発光素子をリード基板に搭載するチップ型の半導体発光装置であって、n側電極及びp側電極のそれぞれの上には導電性材料からなるマイクロパンプを形成し、結晶基板をリード基板に対して上下反転した姿勢としてマイクロパンプをリード基板に形成したリードに接続し、結晶基板の上面を光取出し面としてなるものであり、フリップチップ型とした発光素子のn側電極及びp側電極を形成した後に発光素子の厚みを薄くする製造が可能なので、発光装置をより一層薄型化できるという作用を有する。

【0024】以下に、本発明の実施の形態の具体例を図面を参照しながら説明する。図1は本発明の一実施の形態による窒化ガリウム系化合物半導体発光素子を備えるチップ型発光ダイオードの概要であって、同図の(a)は縦断面図、同図の(b)は平面図である。そして、窒化ガリウム系化合物の半導体を用いた発光素子としては各種の態様のものがあるが、その一例を図2に示す。

【0025】図2の(a)は発光素子1の平面図、同図の(b)は(a)のA-A線矢視による縦断面図である。

【0026】図2の(a)及び(b)において、発光素子1は、絶縁性であって光を透過可能なサファイアを用いた結晶基板1aの表面に複数の半導体薄膜層を従来周知の有機金属気相成長法によって成膜したものである。この薄膜の積層体は、下から順にGaNバッファ層1b、n型GaN層1c、InGaN活性層1d、p型AlGaN層1e及びp型GaN層1fとしたものであり、ダブルヘテロ構造となっている。

【0027】n型GaN層1cの一つのコーナー部の上面はエッチングによって段差状に除去され、この除去された部分にTi及びAuの積層膜とその上にNiとAuの積層膜とを重ねたn側電極2を蒸着法によって形成している。また、エッチングによる切除部分を除いた最上層のp型GaN層1fの上面には、NiとAuの積層膜から成るp側電極3が同様に蒸着法によって形成されている。

【0028】発光素子1を組み込むチップ型の発光ダイオードは、従来例で示したものと同様に、絶縁性のリード基板6に形成されたリード7a、7bを備え、これら

のリード7a、7bに発光素子1を電気的に接続して透明なエポキシ樹脂8によって封止したものである。

【0029】発光素子1は、図1に示すように、結晶基板1aを発光観測面とする姿勢すなわちn側及びp側電極2、3をリード基板6側に向けてマイクロパンプ4、5をそれぞれリード7a、7bに接続して固定されている。そして、結晶基板1aを透明としておくことによって、p-n接合による発光域から図において上向き方向に発光させることができる。

【0030】このようにリード7a、7bにマイクロパンプ4、5を直接接続することによって、ワイヤーボンディングによるワイヤー接続が不要となる。このため、図4に示したようなワイヤー24の上向きの立ち上がりがない構造体となり、この立ち上がり分に相当する窩を含まない厚さにすることができる。たとえば、従来のチップ型の発光ダイオードでは厚さが300~400μm程度であったのが、200~300μm程度まで薄くすることができる。

【0031】また、発光素子1の光取出し面はサファイアを用いた透明の結晶基板1aの表面すなわち図1の(a)において結晶基板1aの上端面となるので、従来のワイヤーボンディングするものに比べると発光の輝度の向上も可能となる。これは、ワイヤーボンディングする場合ではボンディングパッドが光取出し面の一部を占めることになるので、その占有面積に相応して光取出し面積が絞られるのに対し、本発明では上下反転した姿勢の結晶基板1aにはボンディングパッド等の遮蔽物がないことによる。

【0032】以上の例では、絶縁性の結晶基板1aを用いた場合であってn側及びp側の電極2、3が結晶基板1aと対向する一面側に設けたものであって、青色LEDとして提供できるものである。このようにn側及びp側の電極の位置が規制されたものだけでなく、導電性の結晶基板を持つものでもn側及びp側のそれぞれの電極を同一面に配置する構成とすることができる。したがって、結晶基板としては絶縁性でも導電性のいずれでもよく、p側及びn側の電極が結晶基板に対して対向する同一面に含まれるものでありさえすればよい。

【0033】図3はこのようなp側及びn側の電極が結晶基板に対して対向する面に形成されるフリップチップ型の発光素子であって、請求項3に記載の発光装置を対象とする発光素子の構成を示す図である。

【0034】図3に示す発光素子11は、透明のn型GaPの結晶基板11aとして、その上にn型GaAsPグレード層11b及びn型GaAsPコンスタント層11cの積層によりGaAsPのn型層を形成したものである。

【0035】n型GaAsPコンスタント層11cの表面には、製造プロセスにおける亜鉛拡散操作により、上端面に選択的にp型GaAsP層11dが形成されてい

る。そして、n型GaAsPコンスタント層11c及びp型GaAsP層11dのそれぞれの上面には、n側電極12及びp側電極13を形成し、これらの電極12、13には先の例と同様にマイクロバンプ14、15を形成している。

【0036】なお、発光素子11の形成方法は、図2に示した発光素子とほぼ同様の手法とすることができます。

【0037】ここで、図4の従来のチップ型の発光ダイオードに用いたGaAsP系の発光素子23では、n側電極23bを形成する前に発光素子23の厚みを薄くする必要がある。GaPの結晶基板11aはサファイアの結晶基板1aに比べて割れやすいため、発光素子23を薄くする場合、電極形成途中のハンドリング等で発光素子23の割れによる歩留り低下が発生し、発光素子23の薄型化は150~200μmが限界である。

【0038】図3の発光素子11では、n側電極12及びp側電極13を形成する際の発光素子11の厚みは300~400μmと厚いために発光素子11の割れの問題は発生しない。発光素子11の厚みを薄くする工程は、n側電極12及びp側電極13を形成した後に実施するために、図2に示す窒化ガリウム系化合物の発光素子1と同等の90μm程度の薄型化が可能となり、従来の発光素子に比べ格段に薄くすることができます。また、電極形成途中の発光素子11の厚みは厚く、発光素子11を薄型化した後は電極形成を行なわないため、発光素子11の割れを防止できる。したがって、発光素子11の製造においても歩留りを高く維持することができる。

【0039】

【発明の効果】請求項1の発明では、p側及びn側のいずれの電極に対してもワイヤーボンディングによるリード側との電気的接続が不要となるので、ワイヤーの発光素子からの立ち上がりに相当する嵩をなくすことができ、発光装置の薄型化によってその利用分野の拡大した展開が可能となる。また、結晶基板の光取出し面にはボンディング用のパッド等の遮蔽物が一切ないので、光取出し面の全体からの光放出が可能となり、輝度の高い発光が得られる。

【0040】請求項2の発明では、輝度の高い青色の発光が得られるので、発光性に優れた青色発光ダイオードを提供することができる。

【0041】請求項3の発明では、フリップチップ型とした発光素子のn側電極及びp側電極を形成した後に発

光素子の厚みを薄くする製造が可能なので、発光装置をより一層薄型化でき、しかも電極形成過程での結晶基板の割れも防止できるので製品の歩留りも向上する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態による窒化ガリウム系化合物半導体発光素子を含むチップ型発光ダイオードであって、

(a) はその概略縦断面図

(b) はその平面図

【図2】発光素子の詳細であって、

(a) はその平面図

(b) は (a) のA-A線矢視による縦断面図

【図3】請求項3に記載の発光装置に備える発光素子の概略構成図であって、

(a) はその平面図

(b) は (a) のB-B線矢視による縦断面図

【図4】従来のチップ型発光ダイオードの例であって、

(a) はその概略縦断面図

(b) はその平面図

【符号の説明】

1 発光素子

1a 結晶基板

1b GaNバッファ層

1c n型GaN層

1d InGaN活性層

1e p型AlGaN層

1f p型GaN層

2 n側電極

3 p側電極

4, 5 マイクロバンプ

6 リード基板

7a, 7b リード

8 エポキシ樹脂

11 発光素子

11a 結晶基板

11b n型GaAsPグレード層

11c n型GaAsPコンスタント層

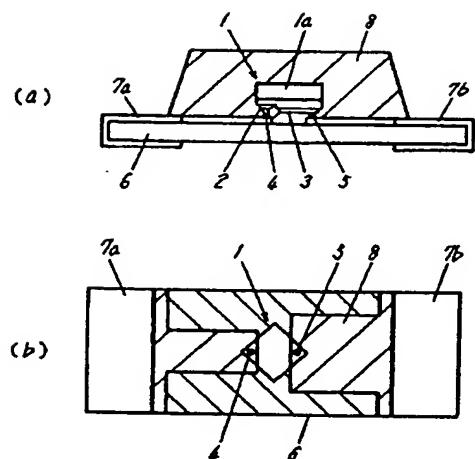
11d p型GaAsP層

12 n側電極

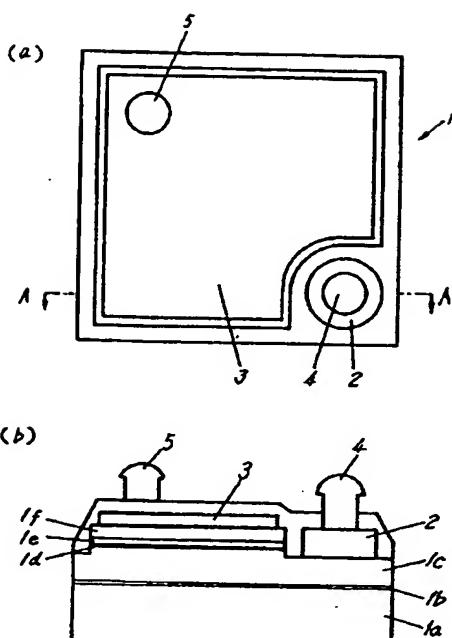
13 p側電極

14, 15 マイクロバンプ

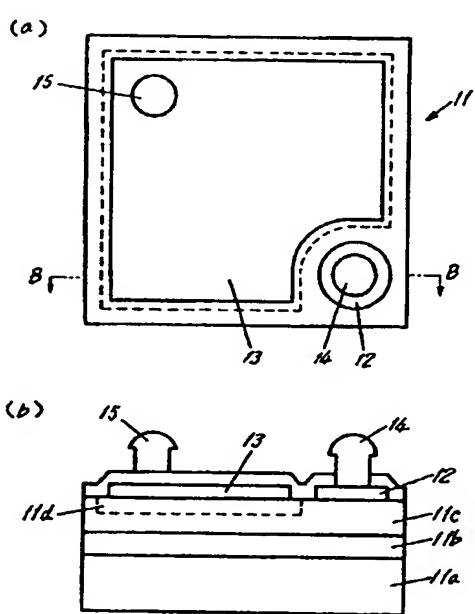
【図1】



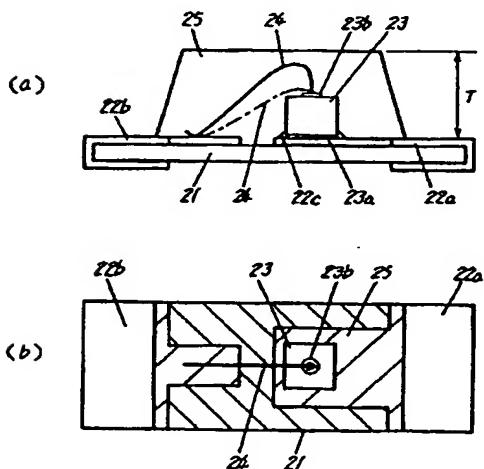
【図2】



【図3】



【図4】



フロントページの続き

(72)発明者 根井 正美

大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業
株式会社内

BEST AVAILABLE COPY